

中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號：416359

[44]中華民國 89年(2000) 12月21日

新型

全 2 頁

[51] Int.Cl 06: B24B7/20  
H01L21/304

第 91106452 號  
初審 (訴願)引証附件  
再審

[54]名稱：控制研磨物均勻度的裝置

[21]申請案號：087219801

[22]申請日期：中華民國 87年(1998) 11月27日

[72]創作人：

陳學忠

吳俊元

盧火鐵

台北縣永和市中正路一九〇巷二號四樓

新竹市振興路四十八巷五弄二十四號三樓之一

台北市復興北路五一三號三樓

[71]申請人：

聯華電子股份有限公司

新竹科學工業園區新竹市力行二路三號

[74]代理人：詹銘文先生

[57]申請專利範圍：

1. 一種控制研磨物均勻度的裝置，用以使一待磨物達到平坦化的目的，該裝置包括：  
一氣囊，具有複數圈氣管；以及  
一氣囊控制器，耦接至該些氣管，選擇性地控制該些氣管之排氣與充氣動作，用以吸起該待磨物及控制該待磨物於研磨時不同區域所受之壓力。
2. 如申請專利範圍第1項所述之控制研磨物均勻度的裝置，其中該複數圈氣管的排列包括以不同半徑大小之方式，在該氣囊內成環形分佈排列。
3. 如申請專利範圍第1項所述之控制研磨物均勻度的裝置，其中該待磨物包括半導體晶片。
4. 如申請專利範圍第1項所述之控制研磨物均勻度的裝置，其中該氣囊控制器包括一抽氣裝置，耦接至該些氣管，用以

對該氣囊內之該些氣管進行排氣動作。

5. 如申請專利範圍第4項所述之控制研磨物均勻度的裝置，其中該氣囊控制器更包括一多通路選擇裝置，一端耦接至該抽氣裝置，另一端耦接至該些氣管，用以控制該抽氣裝置對該些氣管的排氣動作。
6. 如申請專利範圍第1項所述之控制研磨物均勻度的裝置，其中該氣囊控制器包括一充氣裝置，耦接至該些氣管，用以對該氣囊內之該些氣管進行充氣動作。
7. 如申請專利範圍第6項所述之控制研磨物均勻度的裝置，其中該氣囊控制器更包括一多通路選擇裝置，一端耦接至該充氣裝置，另一端耦接至該些氣管，用以控制該充氣裝置對該些氣管的充氣動作。
8. 如申請專利範圍第1項所述之控制研磨

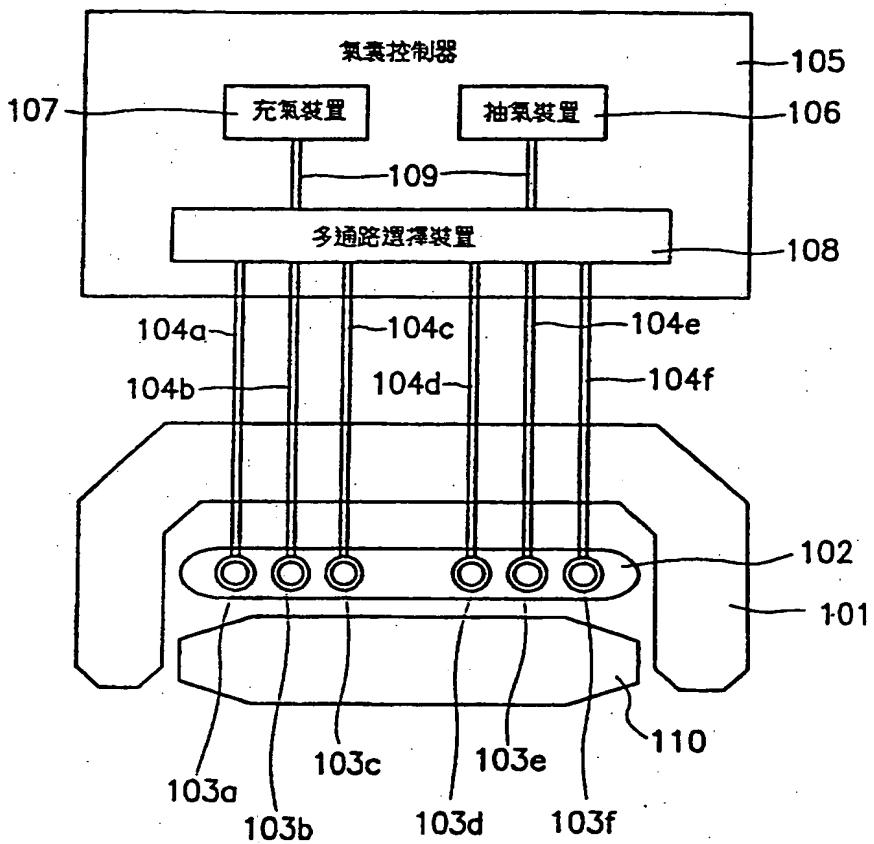
物均勻度的裝置，其中該氣囊控制器包括一抽氣裝置與一充氣裝置，耦接至該些氣管，用以對該氣囊內之該些氣管進行排氣與充氣動作。

9.如申請專利範圍第8項所述之控制研磨物均勻度的裝置，其中該氣囊控制器更包括一多通路選擇裝置，一端耦接至該

抽氣裝置與充氣裝置，另一端耦接至該些氣管，用以控制該抽氣裝置與該充氣裝置對該些氣管的排氣與充氣動作。

圖式簡單說明：

5. 第一圖係繪示依據本創作之一較佳實施例之一種氣囊式背墊的浮動式研磨頭之裝置剖面示意圖。



第一圖